YUSEEKER

예성 다이아몬드

정직 · 창조 · 일류

하남성 예성다이아몬드

TEL：86-371-5559 2007

Http：www.microndiamond.com

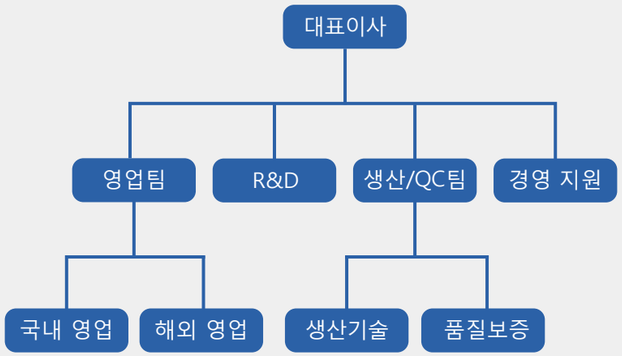
Factory: Industrial Zone, Huanfeng, Xiuwu County,Jiaozuo, Henan ,China.454350

Office：North Jingbei 2th Rd, EPZ, Zhengzhou,Henan,China. 450016

E-mail：sarali@microndiamond.com

01

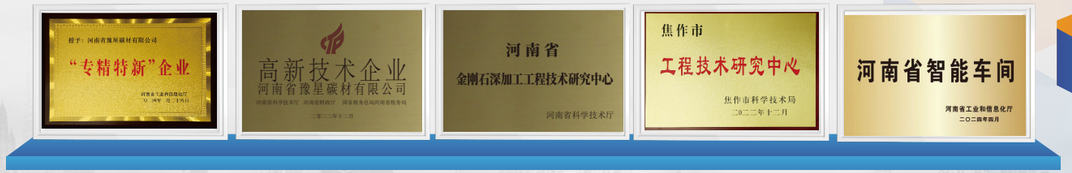
회사 소개



하남성 예성다이아몬드는 공업용 합성 다이아몬드파우더 및 관련 소재를 생산하는 기업입니다. 예성다이아몬드는 선진적인 생산기술을 보유하고 있어 고객님의 다양한 요구를 충분히 이해하고 개인화된 솔루션을 제공가능합니다.

예성다이아몬드는 지난 수십 년 동안 급속한 성장과 혁신을 경험하며 중국 다이아몬드파우더를 선도하는 산업 중 하나로 자리매김해왔습니다. 예성다이아몬드의 임직원과 파트너들은 상호 이익과 윈윈을 실현할 수 있도록 매일 최선의 노력을 다하고 있습니다.

앞으로는 예성다이아몬드는 글로벌 시장에 대한 깊은 통찰력과 한계를 뛰어넘는 기술력과 혁신을 바탕으로 더 넓은 세상에어 더 큰 성공을 이루어가며 그 가치를 인정받겠습니다.



02 생산공정

01 파쇄
02 정형
03 정화
04 분급
05 건조
06 검사

03 품질관리

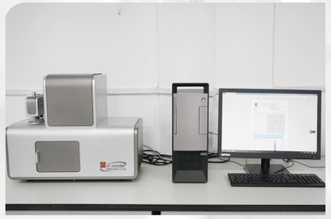
원료 검사
- 불순물 검사
- 강도 검사

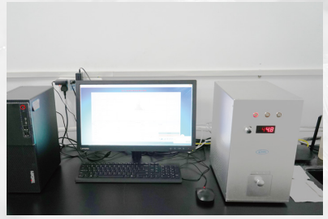
과정 검사
- 사이즈 검사
- 형상 검사

완제품 검사
- 사이즈 검사
- 형상 검사
- 불순물 검사

출고 검사
- 사이즈 검사
- 형상 검사

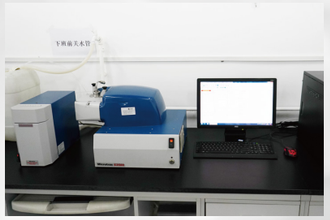
기타 검사
- SEM
- ICP


BT2800 Dynamic Image Particle Size Analyzer


Raman Spectrum Analyzer

Beckman Coulter Particle Size Analyzer

Malvern 3000 Laser Particle Size Analyzer

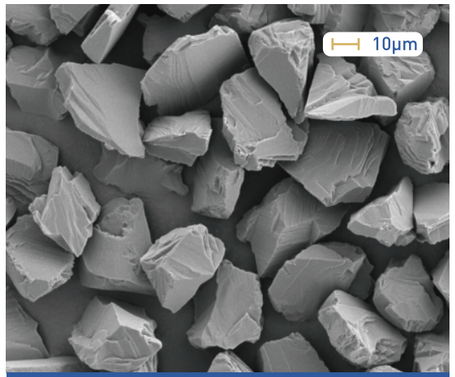

Microtrac S3500 Laser Particle Size Analyzer

Microtrac S3500 Particle Morphology Analyzer

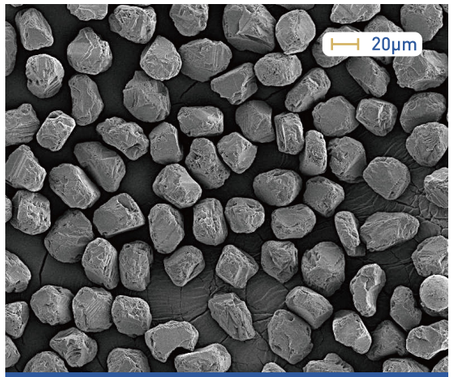
04 제품 경쟁력

형상 특성

날카로운 다이아몬드 파우더와 동그란 다이아몬드 파우더를 다 공급가능합니다.



Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=7.4mm Mag=5.00KX



Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=9.1mm Mag=1.00KX

ICP 관리

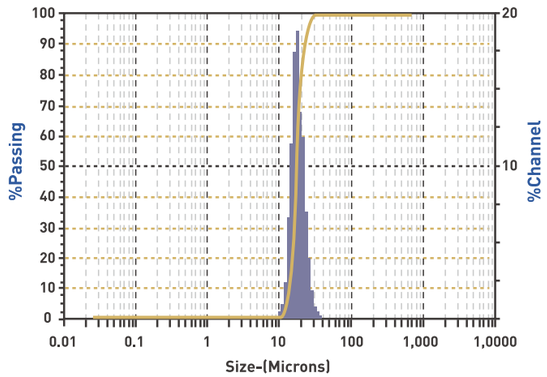
회사의 자체적인 공법 개발을 통해 다이아몬드 파우더 표면의 순도, 분산성, 안정성을 엄격히 관리합니다.

型号	粒度	Al	Ca	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	K	Li	Mg	Mn	Na	Ni	Pb	Si	Zn	PPM in total
SCMD-AA	12-22	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	16
SCMD-AA	8-12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	13
SCMD-AA	50nm	1	8	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	2	0	16	0	46

집중도 관리

2μm이하 제품을 기준으로 16개 사이즈로 분급 가능합니다.
입자 분포가 특히 집중되어 형상과 입자가 균일합니다.

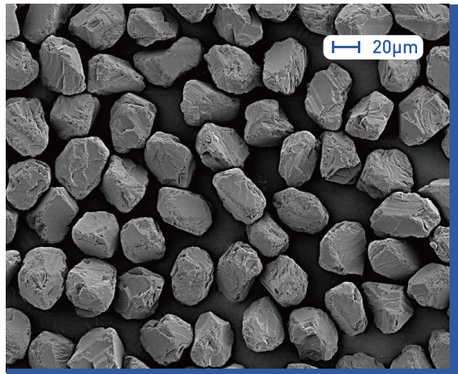
0-0.05	0-0.1	0-0.125	0.1-0.2	0-0.2	0-0.25	0.25-0.5	0-0.5
0-1	0.5-1	0.75-1.25	0.5-1.5	1-1.5	1.5-2	0-2	1-2



Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=9.1mm Mag=1.00KX

05 제품 소개

MICRON 다이아몬드

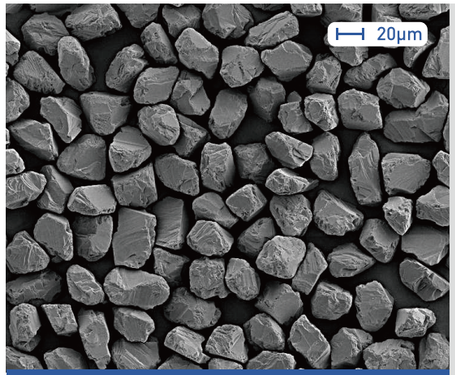


Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=10.2mm Mag=1.00KX

SCMD-AA

제품특성: 양질의 MBD다이아몬드를 사용하여 특수한 정형공법을 거쳐 형상이 타원형에 가깝고 규칙적이며 사이즈가 집중적으로 분포하고 불순물 함량이 낮아 표면이 매우 깨끗합니다.

용도: 초정밀 가공, 메탈 본드, 비트리파이드 본드, 전착제품과 연마제품에 적용됩니다.

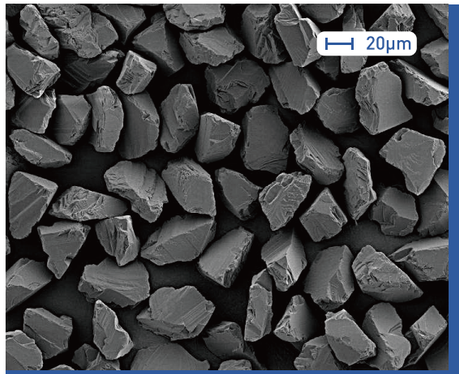


Signal A=SE2 EHT=5 00kV WD=10 2mm Mag=1 00KX

SCMD-A

제품특성: 양질의 SCD다이아몬드를 사용하여 국제표준화 기준에 따라 생산하고 있습니다. 형상이 균일하고, 불순물 함량도 적으며, 사이즈가 집중적으로 분포합니다.

용도: 메탈 본드, 비트리파이드 본드, 전착제품과 연마제품에 적용됩니다.

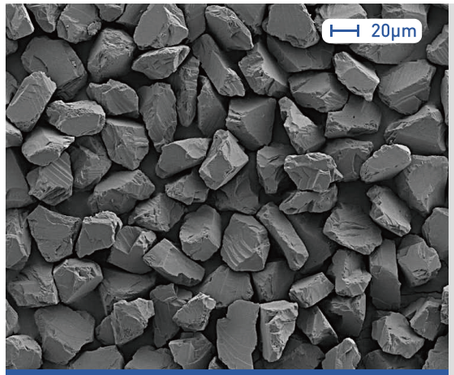


Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=10.2mm Mag=1.00KX

SCMD-B

제품특성: 보통 SCD다이아몬드를 사용하여 국제표준화 기준에 따라 생산하고 있습니다. 형상이 비교적 균일하고, 불순물 함량도 비교적 적으며, 사이즈 분포는 집중됩니다.

용도: 비트리파이드 본드, 레진 본도, 전착제품과 연마제품에 적용됩니다.



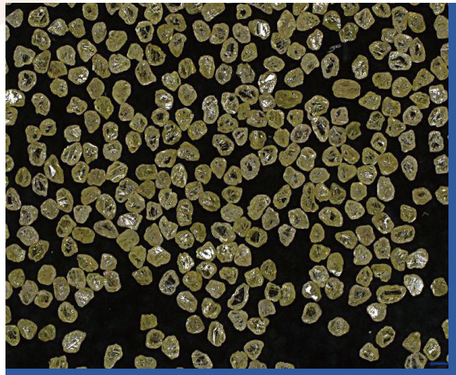
Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=7.4mm Mag=1.00KX

SCMD-C

제품특성: 보통 RVD다이아몬드를 사용하여 국제표준화 기준에 따라 생산하고 있습니다. 형상이 비교적 균일하고, 불순물 함량도 비교적 적으며, 사이즈 분포는 집중됩니다.

용도: 레진 본도와 연마제품에 적용됩니다.

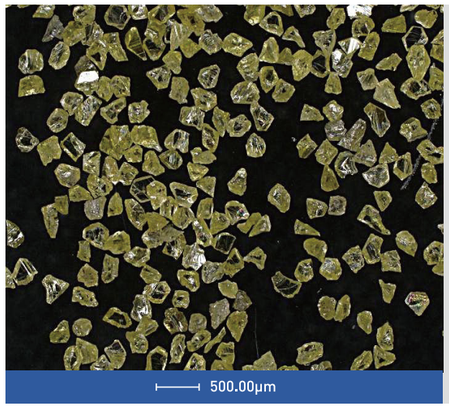
MESH 다이아몬드



SCDZ

제품특성: 양질의 MBD다이아몬드를 원료로 사용하여, 특수한 파쇄, 정형공정을 거쳐 가공됩니다. 형상은 타원형에 가깝고 규칙적이며 불순물 함량이 낮습니다.

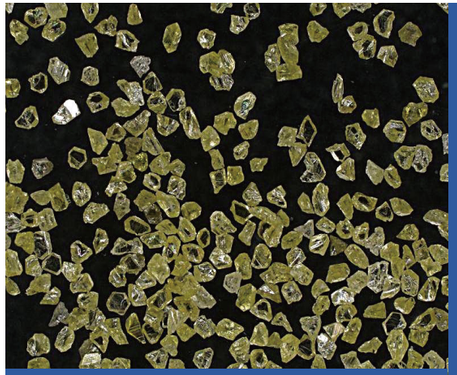
용도: 메탈 본드, 비트리파이드 본드와 전착제품에 적용됩니다.



SCDA

제품특성: 양질의 SCD다이아몬드를 원료로 사용하여, 특수한 파쇄기법으로 가공하며, 형상이 불규칙하고 날카롭습니다.

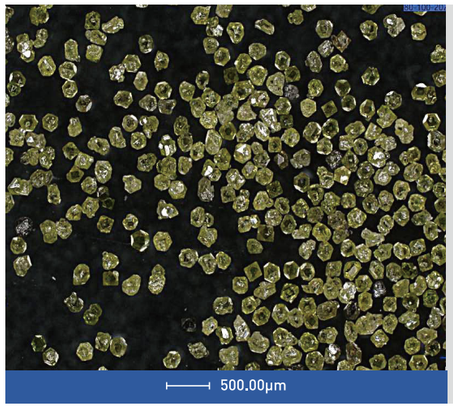
용도: 메탈 본드, 비트리파이드 본드와 전착제품에 적용됩니다.



SCDB

제품특성: 보통 SCD다이아몬드를 원료로 사용하여, 특수한 파쇄기법으로 가공하며, 형상이 불규칙하고 날카롭습니다.

용도: 비트리파이드 본드, 레진 본드와 전착제품에 적용됩니다.

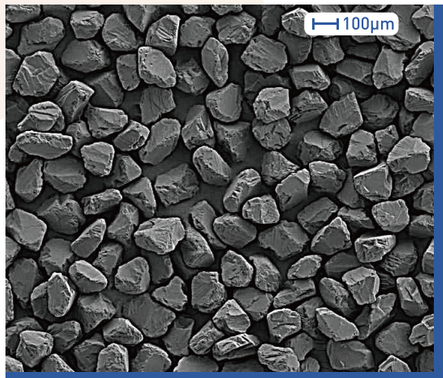


RVD

제품특성: 보통 RVD다이아몬드를 원료로 사용하여, 특수한 파쇄기법으로 가공하며, 형상이 불규칙하고 날카롭습니다.

용도: 레진 본드와 전착제품에 적용됩니다.

SCMD-PCD/PDC

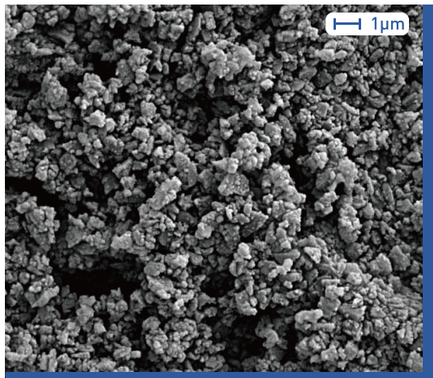


Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=7.4mm Mag=500X

제품특성: 고강도, 고순도의 MBD다이아몬드 원료로 사용하여 형상이 규칙적이고 사이즈가 집중적으로 분포하며, 불순물 함량이 낮고 열안정성이 좋을 뿐만 아니라 내마모성도 높습니다. 특수공법 처리로 미크론 파우더 표면이 깨끗합니다.

용도: PCD/PDC, 메탈 본드 제품, 비트리파이드 본드 제품에 적용됩니다.

SCMD-ND

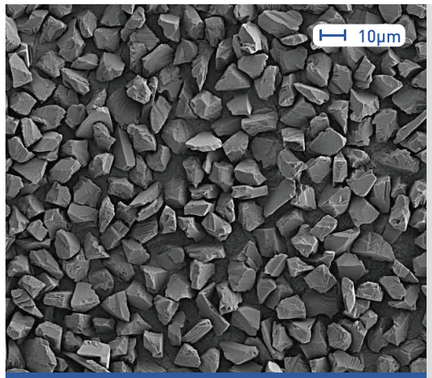


Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=7.4mm Mag=50.00KX

제품특성: 특수한 생산공법으로 거쳐 사이즈 분산이 집중되고 우수한 Polishing 효과가 있습니다. 또한 우수한 내마모성, 내부식성, 열전도성 그리고 안정적인 분산성을 가지며 순도가 매우 높습니다.

용도: 초정밀 연마, 윤활제, 표면 도금및 산열재료로 사용합니다.

SCMD-WD

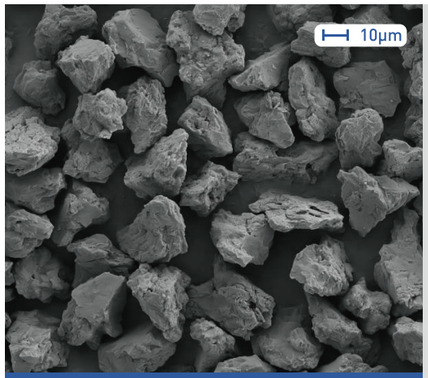


Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=7 .4mm Mag=500X

제품특성: 고강도, 고순도의 MBD다이아몬드 원료로 사용하여 특수공법 처리로 가공됩니다. 형상이 규칙적이고 절삭 작업을 하는 입자가 많으며, 강도가 높고 불순물 함량이 적을 뿐만 아니라, 입자크기가 집중적으로 분포됩니다.

용도: Wire Saw, 보석가공용Saw, 반도체용Saw 등에 적용됩니다. 또한 모노실리콘, 폴리실리콘, 사파이어, 석영, 액정유리, 고정밀 자성재료, 반도체 등 고급 소재의 절삭, 연마, 폴리싱 등에 적용됩니다.

SCMD-PD

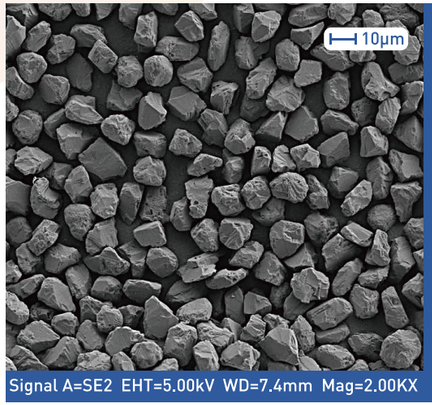


Signal A=SE2 EHT=5.00kV WD=7 . 4mm Mag=5.00KX

제품특성: 폭발법으로 제조한 미크론 파우더이며, 두번의 자사만의 특수한 정형기법, 정밀한 분급기법, 불순물 처리기법 등을 거쳐 사이즈 범위가 좁고 순도가 높으며, 절삭작업을 하는 입자가 많습니다.

용도: IT산업중 실리콘 칩(Silicon chip)의 가공에 광범위하게 적용됩니다. 그리고 루비/사파이어 등의 정밀가공, 세라믹, 광학렌즈, 광섬유의 정밀가공 영역에도 적용됩니다.

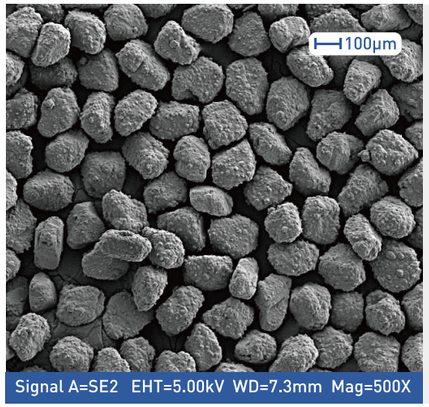
SCMD-SSD



제품특성: 레진다이아몬드는 고온고압 특수공법으로 생산됩니다. 다결정과 비슷한 성능을 가지며 표면이 거칠고 형상이 불규칙적이며 쉽게 부스러집니다. 우수한 절삭능력이 있습니다.

용도: 레진 본드 제품과 표면의 매끄러운 정도에 대한 특수요구가 있는 소재의 연마, 폴리싱에 적용됩니다.

SCMD-CDP



제품특성: 코팅제품은 일반적으로 니켈(Ni), 티타늄(Ti), 구리(Cu)를 사용하여 다이아몬드나 CBN 표면에다가 코팅하여 보지력을 높입니다. 열충격을 감소시키고, 다이아몬드나 CBN를 보호하여 산화와 흑연화를 방지할 뿐 아니라, 사용수명을 연장할 수 있습니다.

용도: 메탈 본드, 비트리파이드 본드, 레진 본드와 전착제품에 적용됩니다.

사이즈 표준

MICRON	SIZE	MESH	D50 (μm)
W0.2	0-0.2	80000	0.9～0.11
W0.25	0-0.25	60000	0.11～0.20
W0.5	0-0.5	30000	0.20～0.30
W1	0-1	15000	0.4～0.6
w1	0.5-1	14000	0.6～0.8
W1.5	0-2	13000	0.8～1.0
W1.5	1-2	12000	1.1～1.5
W2.5-	1-3	10000	1.5～1.9
W2.5+	2-3	7000	1.9～2.5
W3	2-4	6500	2.5～3.0
W3.5	2-5	5000	3.1～3.5
W5-	3-5	4000	3.5～4.5
W5	4-6	3500	4.5～5.4
W7	4-8	3000	5.4～6.8
W10	5-10	2000	6.8～7.5
W10	6-12	1800	7.5～8.6
W12	8-12	1600	8.6～9.5
W14	7-14	1500	9.5~10.5
W14	8-16	1300	10.5～12
W14+	10-15	1200	12～13.5
W20-	10-20	1000	13.5～15.5
W20	12-22	850	15.5～17.6
W20+	15-25	800	17.6～20.5
W28	20-30	700	20.5～25.5
W28+	20-40	500	25.5～31
W40	30-40	450	31～37
W40+	30-50	375	37～41
W50	40-50	350	41～46
W50+	40-60	300	46～51